



鸿富诚

专业·专心·专注

创新功能材料领军企业

H200-S40 专用系列

【导热硅胶垫片】规格书



-产品图-

应用特点：

- 低压力应用、压缩性好
- 低热阻
- 高撕裂强度
- 良好的界面接触
- 良好的绝缘性、耐高压击穿

应用领域推荐：

- 芯片与散热模块之间
- 光电行业
- 网通产品
- 汽车电子
- 可穿戴设备

该系列产品符合RoHS、HSF、卤素管控标准。

储存条件：阴暗处储存

储存温度：≤30°C

储存湿度：≤70%

堆放高度不超过7层，而且总高度不超过1M

保质期：

在储存条件下：二年

不符合储存条件下：六个月

产品性能

NO.	参数	单位	测试方法
颜色	灰色	---	目视
厚度	1~4	mm	ASTM D 374
硬度	40±5	Shore 00	ASTM D 2240
密度	2.5±0.2	g/cc	ASTM D 792
拉伸强度	≥0.2	Mpa	ASTM D 412
延伸率	≥150	%	ASTM D 412
撕裂强度	≥1.5	N/mm	ASTM D 624
压缩保持力	20%	6.62	Psi
	30%	12.15	Psi
阻燃等级	V0	---	UL-94
使用温度	-50~180	°C	IEC 60068-2-14

热学特性

导热系数	2.0±0.1	W/m·K	ASTM D 5470
热阻	≤1.5 (@20Psi/2mm)	°Cin ² /W	ASTM D 5470

电学特性

击穿电压	≥10	KV/mm	ASTM D 149
体积电阻率	≥10 ¹⁰	Ω·cm	ASTM D 257
介电常数	≥2	@1MHz	ASTM D 150
介质损耗	≤0.1	@1MHz	ASTM D 150

以上数据由鸿富诚实验室提供，该实验室保留最终解释权

